

# 2026年3月期（2025年4月～2026年3月） 東京エレクトロン 決算説明会

2026年4月30日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）

# 将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

# 2026年3月期 連結決算の概要

2026年4月30日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー  
川本 弘



# 損益状況（四半期）

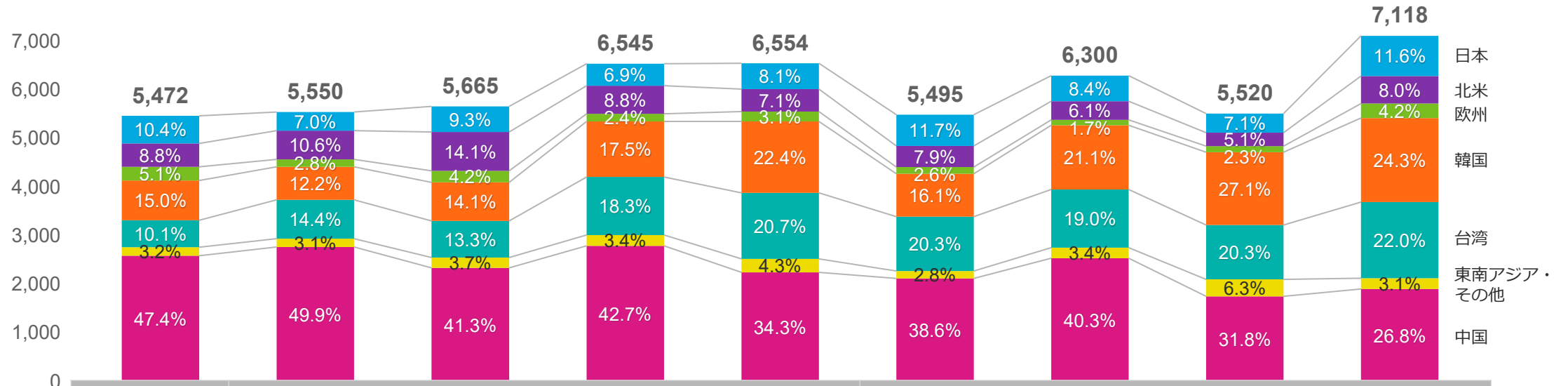
（億円）

	FY2025	FY2026				vs. FY2026 Q3	vs. FY2025 Q4
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
売上高	6,554	5,495	6,300	5,520	<b>7,118</b>	+28.9%	+8.6%
売上総利益	3,105	2,539	2,848	2,358	<b>3,331</b>	+41.3%	+7.3%
売上総利益率	47.4%	46.2%	45.2%	42.7%	<b>46.8%</b>	+4.1pts	-0.6pts
販管費	1,267	1,092	1,264	1,196	<b>1,275</b>	+6.6%	+0.6%
営業利益	1,837	1,446	1,584	1,161	<b>2,056</b>	+77.1%	+11.9%
営業利益率	28.0%	26.3%	25.1%	21.0%	<b>28.9%</b>	+7.9pts	+0.9pts
税金等調整前当期純利益	1,851	1,519	1,610	1,533	<b>2,818</b>	+83.8%	+52.2%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,429	1,178	1,238	1,185	<b>2,142</b>	+80.8%	+49.9%
研究開発費	727	621	726	662	<b>767</b>	+15.9%	+5.6%
設備投資額	346	528	912	303	<b>416</b>	+37.3%	+20.4%
減価償却費	183	171	191	211	<b>235</b>	+11.3%	+28.2%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。
3. FY2025は2024年4月～2025年3月の会計年度を指しています。FY2026は2025年4月～2026年3月の会計年度を指しています。

# 地域別売上高構成比（四半期）

(億円)



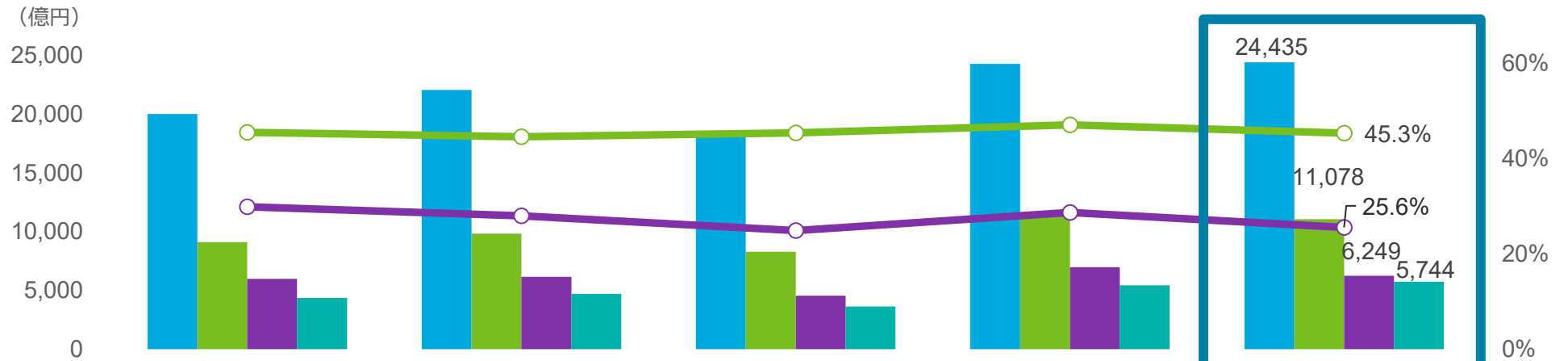
	FY2024			FY2025				FY2026			
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
日本	567	385	526	453	534	643	529	393	828		
北米	483	590	799	577	462	434	384	278	567		
欧州	281	155	238	157	203	140	108	127	297		
韓国	820	678	795	1,145	1,470	883	1,325	1,497	1,731		
台湾	552	800	753	1,193	1,358	1,115	1,197	1,119	1,565		
東南アジア・その他	175	170	212	223	278	156	213	348	221		
中国	2,591	2,770	2,339	2,794	2,246	2,121	2,541	1,755	1,907		

# 損益状況（通期）

	FY2025	FY2026	対前期 増減	(ご参考) 2026年2月6日発表の FY2026予想
売上高	24,315	24,435	+0.5%	24,100
売上総利益 売上総利益率	11,462 47.1%	11,078 45.3%	-3.4% -1.8pts	10,920 45.3%
販管費	4,489	4,829	+7.6%	4,990
営業利益 営業利益率	6,973 28.7%	6,249 25.6%	-10.4% -3.1pts	5,930 24.6%
税金等調整前当期純利益	7,061	7,481	+6.0%	7,140
親会社株主に帰属する当期純利益	5,441	5,744	+5.6%	5,500
1株当たり当期純利益（円）	1,182.40	1,254.57	+6.1%	1,200.05
研究開発費	2,500	2,778	+11.1%	2,900
設備投資額	1,621	2,160	+33.2%	2,400
減価償却費	621	809	+30.3%	860

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。  
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

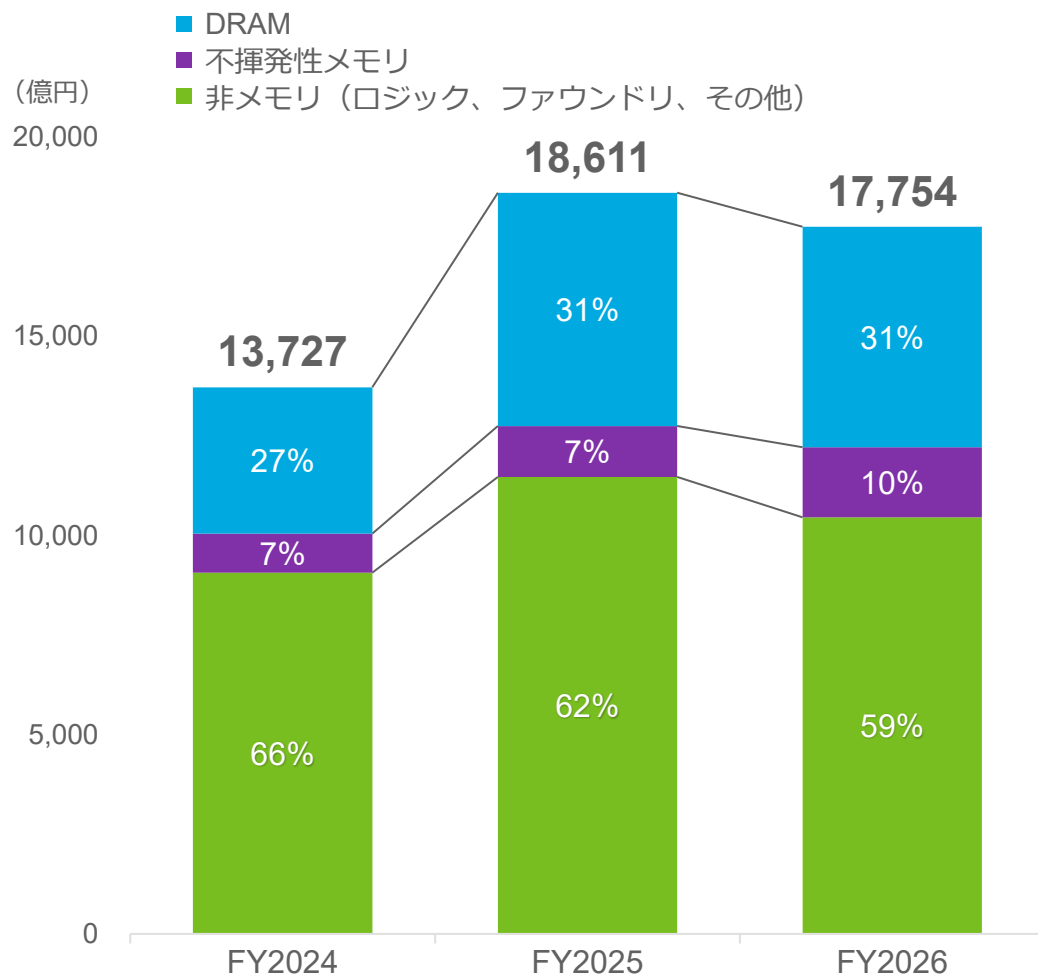
# 損益状況の推移 (FY2022~FY2026)



	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
■ 売上高	20,038	22,090	18,305	24,315	<b>24,435</b>
■ 売上総利益	9,118	9,844	8,302	11,462	<b>11,078</b>
■ 営業利益	5,992	6,177	4,562	6,973	<b>6,249</b>
■ 親会社株主に帰属する 当期純利益	4,370	4,715	3,639	5,441	<b>5,744</b>
○ 売上総利益率	45.5%	44.6%	45.4%	47.1%	<b>45.3%</b>
○ 営業利益率	29.9%	28.0%	24.9%	28.7%	<b>25.6%</b>
ROE	37.2%	32.3%	21.8%	30.3%	<b>29.6%</b>

売上高は過去最高の業績を達成

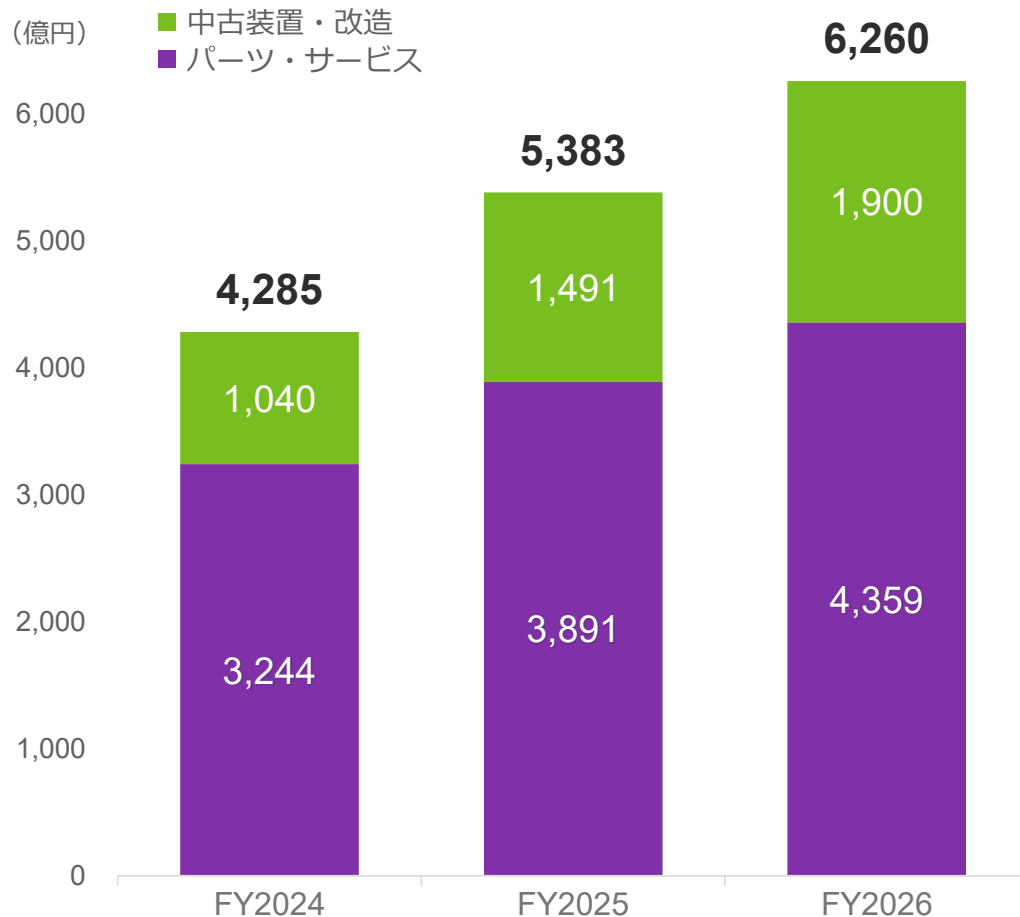
# SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比



- DRAM :
  - HBM向けなど先端投資が引き続き堅調
- 不揮発性メモリ :
  - 顧客の工場稼働率は改善  
投資は徐々に回復基調  
売上、構成比率ともに増加傾向
- 非メモリ :
  - 最先端設備投資が活発

1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置  
2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれておりません。

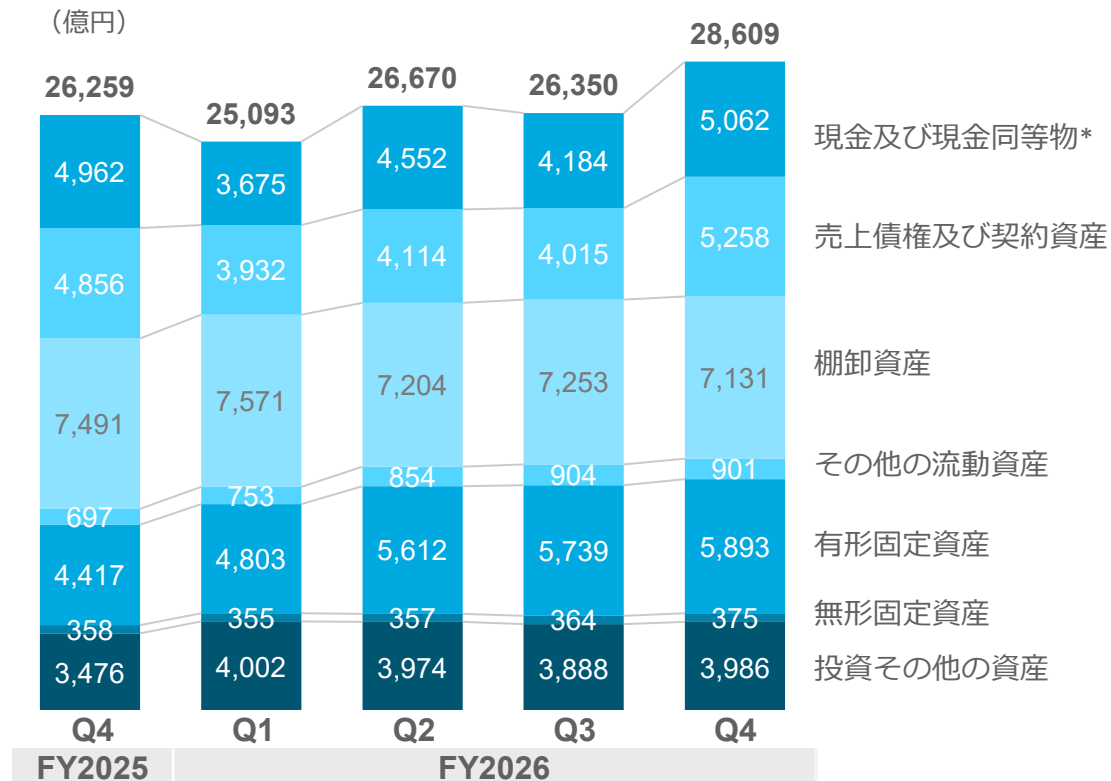
# フィールドソリューション売上



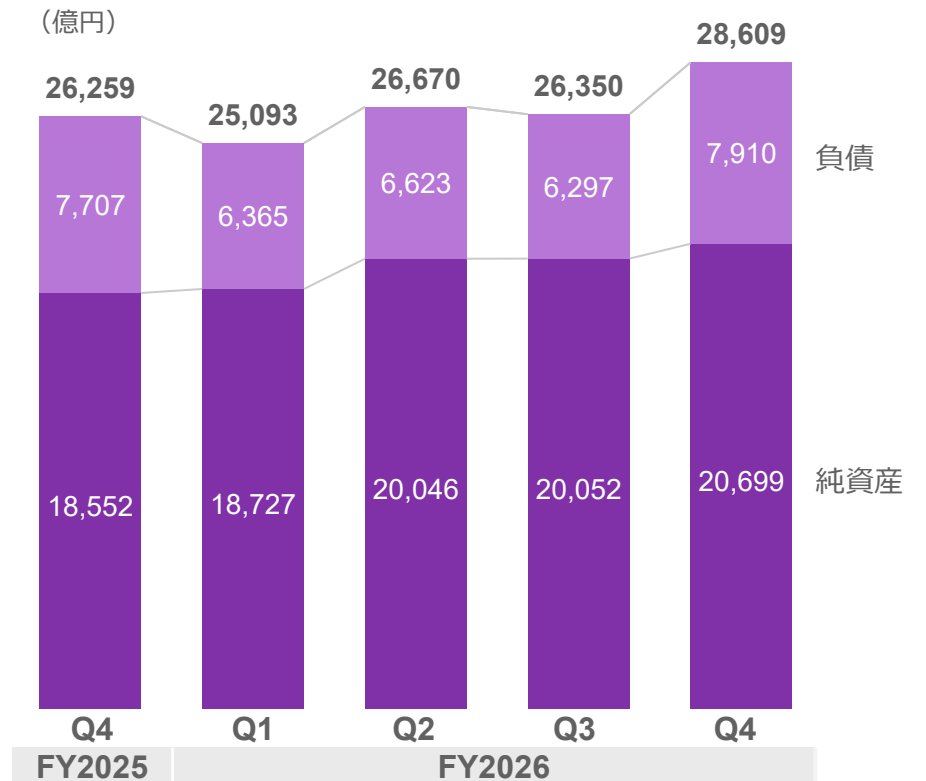
- FY2026の売上は、前期比16.3%増の6,260億円
- 顧客の工場稼働率が一段と上昇し、パーツ・サービス、改造ともに好調

# 貸借対照表（四半期）

## 資産

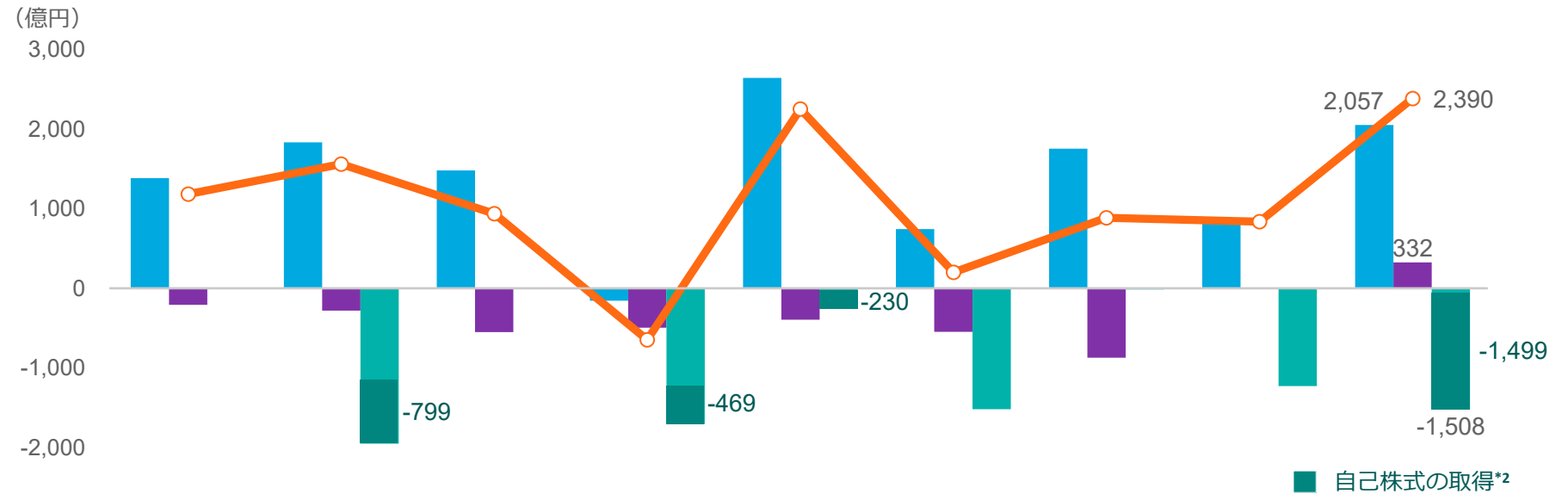


## 負債・純資産



\*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

# キャッシュ・フロー（四半期）



	FY2024	FY2025				FY2026			
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
■ 営業キャッシュ・フロー	1,390	1,837	1,486	-150	2,648	749	1,758	831	<b>2,057</b>
■ 投資キャッシュ・フロー*1	-203	-273	-544	-490	-389	-541	-867	12	<b>332</b>
■ 財務キャッシュ・フロー	-6	-1,944	-6	-1,701	-235	-1,511	-10	-1,223	<b>-1,508</b>
○ フリーキャッシュ・フロー*3	1,187	1,564	941	-641	2,258	207	891	843	<b>2,390</b>
手元資金残高*4	4,725	4,385	5,255	2,955	4,962	3,675	4,552	4,184	<b>5,062</b>

\*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

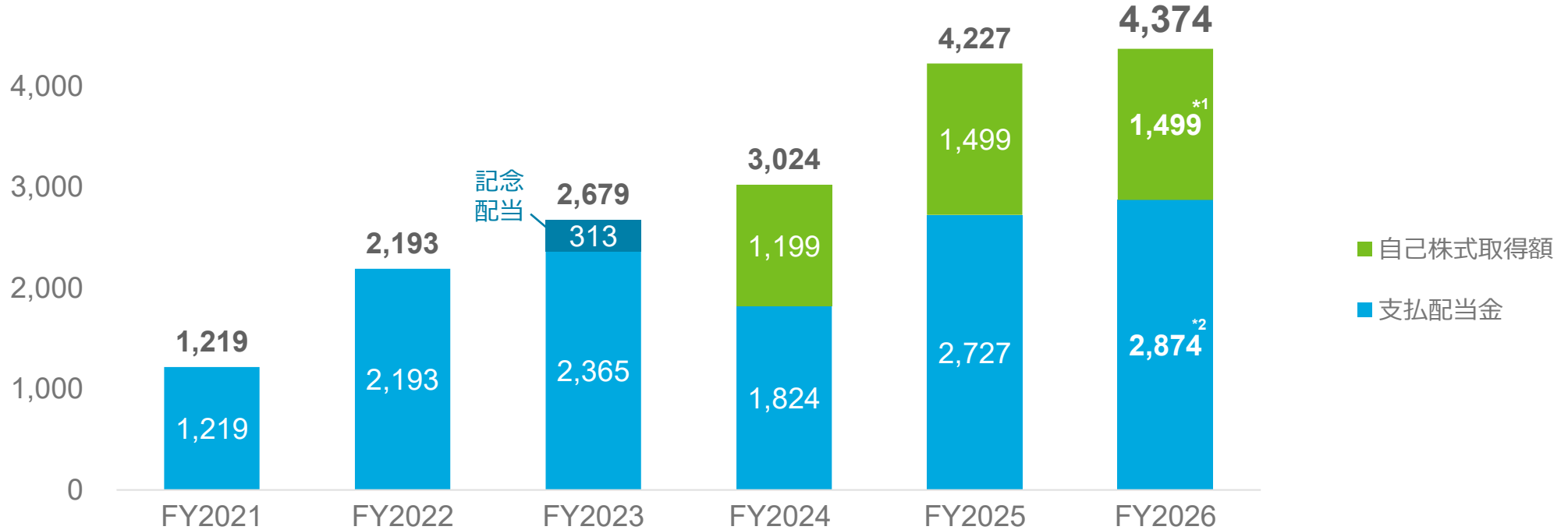
\*2 自己株式の取得は、単元未満株式の買取りに要した金額を除いた金額です。

\*3 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

\*4 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3か月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

# 総還元額

(億円)



\*1 [https://www.tel.co.jp/news/ir/2026/bk8a0u00000000j1-att/20260327\\_002.pdf](https://www.tel.co.jp/news/ir/2026/bk8a0u00000000j1-att/20260327_002.pdf)

\*2 2026年3月期の期末配当額については取締役会決議前の予定額です。

自己株式取得と合わせ、過去最高の総還元額

# 事業環境および業績予想

2026年4月30日

代表取締役社長・CEO  
河合 利樹



# 2026年3月期 事業ハイライト

## 過去最高の 売上高・当期純利益

- 売上高
  - Q4 : 7,118億円
  - 通期 : 2兆4,435億円
- 当期純利益
  - Q4 : 2,142億円
  - 通期 : 5,744億円

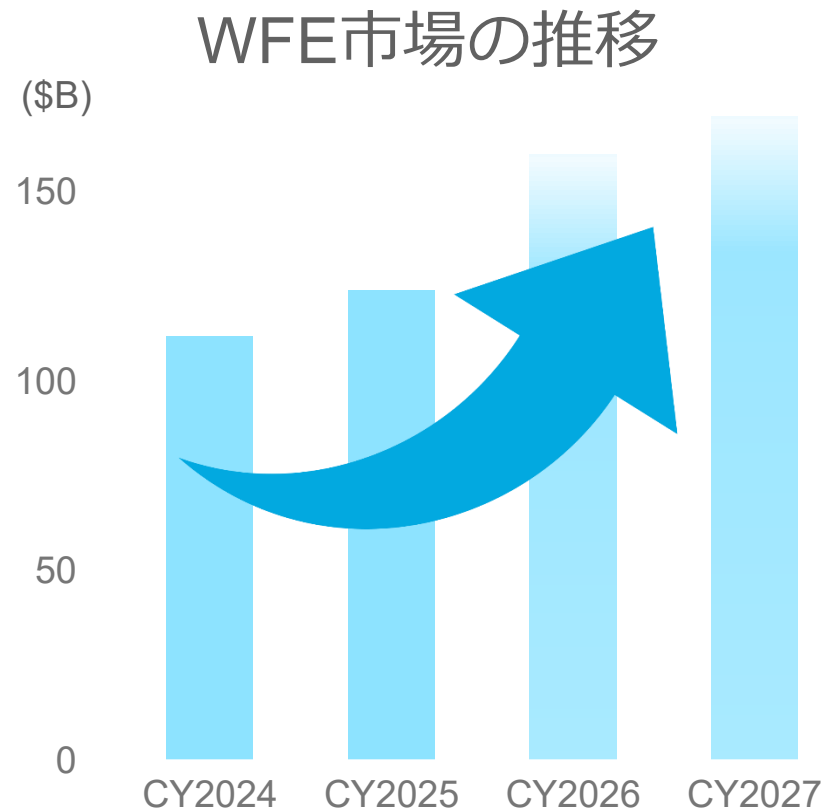
## 次なる成長へ 盤石なインフラを準備

- 竣工
  - 宮城・熊本の新開発棟
  - 岩手の生産・物流センター
- 着工
  - 宮城の生産新棟 : スマートプロダクション構想を採用

## 成長が期待される 先端領域でのPOR獲得

- メモリ
  - キャパシタ・HBM配線層など主要工程のPORを専有
- アドバンストパッケージング
  - 複数の製品がPORを獲得

## 事業環境 (2026年4月時点でのWFE市場の見方)



### CY2026~2027 WFE市場の見通し

- \$150B~170B/年のレンジ  
(CY2025比 +20%以上) で想定
- 先端デバイス向けは +30%以上
- 地政学的リスクは要注視

# 2027年3月期 売上成長ドライバー

## 塗布・現像

- マーケットシェア 90%以上
- DRAMと先端ロジックにおける大幅な投資増の機会を捉える
- FY2027売上 YoY +50%以上

## エッチング

- マーケットシェア 50%以上（絶縁膜エッチング）
- HARC工程、配線工程、GAA工程
- FY2027売上 YoY +25%以上

## アドバンスト パッケージング

- 先端ロジック向けプローバ専有、高シェアHBM向けボンディング装置
- 塗布・現像、エッチング、成膜装置などのPOR拡大
- FY2026 売上実績 約2,000億円、FY2027 売上 YoY +60%以上

# 2027年3月期 業績予想

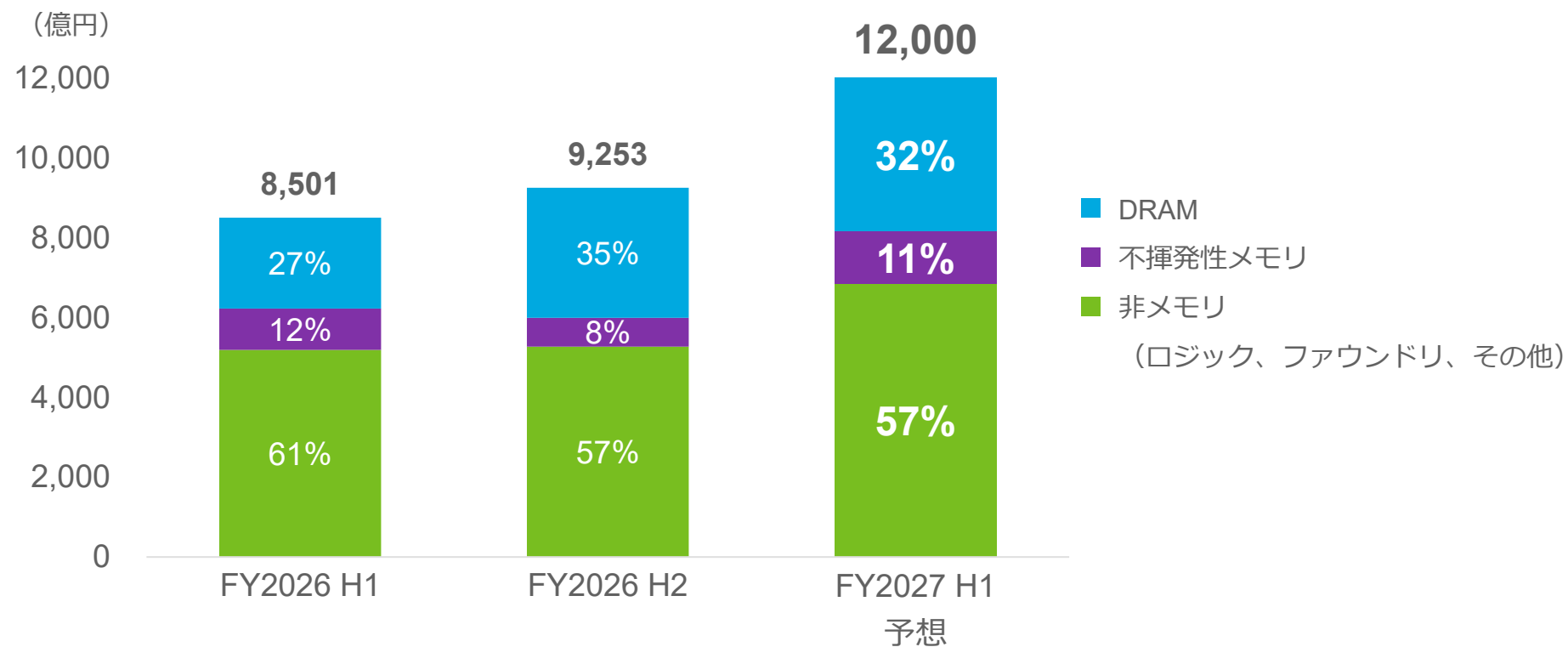
(億円)

	FY2026 (実績)			FY2027 (予想)
	H1	H2	通期	H1
売上高	11,796	12,638	24,435	15,700
売上総利益 売上総利益率	5,388 45.7%	5,690 45.0%	11,078 45.3%	7,150 45.5%
販管費	2,357	2,472	4,829	2,840
研究開発費	1,348	1,430	2,778	1,600
研究開発費以外の販管費	1,009	1,041	2,050	1,240
営業利益 営業利益率	3,031 25.7%	3,217 25.5%	6,249 25.6%	4,310 27.5%
税金等調整前当期純利益	3,129	4,351	7,481	4,370
親会社株主に帰属する当期純利益	2,416	3,328	5,744	3,280
1株当たり当期純利益 (円)	527.31		1,254.57	721.12

- FY2027 上期：  
AIサーバー向け需要が牽引し、過去最高の売上高、売上総利益、営業利益を見込む
- 2026年後半にかけて、DRAM・先端ロジックを中心に更に出荷が増加
- ホルムズ海峡の封鎖の影響は要注視

# 2027年3月期 SPE新規装置売上予想

## アプリケーション別売上構成比



\* グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

## SPE新規売上が伸長し、前年同期比+41%

# 2027年3月期 研究開発費・設備投資計画

宮城 第3開発棟  
エッチング装置



宮城県黒川郡  
2025年4月 竣工

熊本 プロセス開発棟  
コータ/デベロッパ、洗浄装置



熊本県合志市  
2025年10月 竣工

東北生産・物流センター  
成膜装置

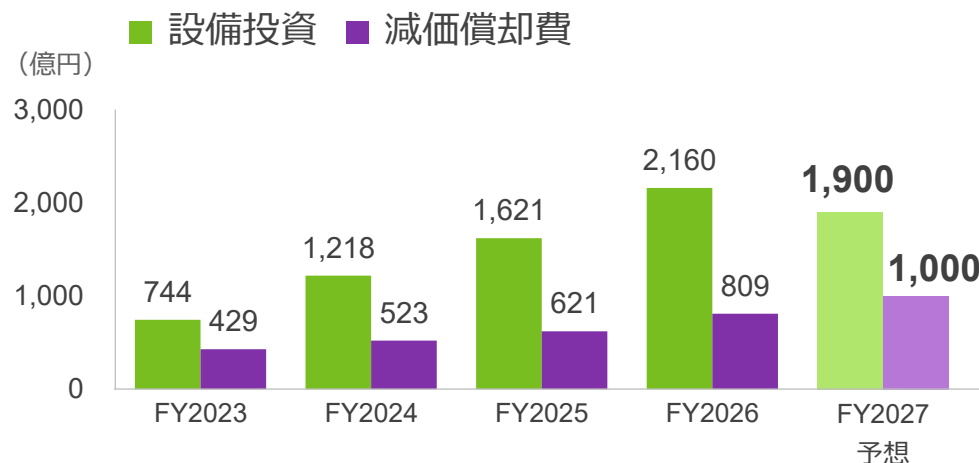
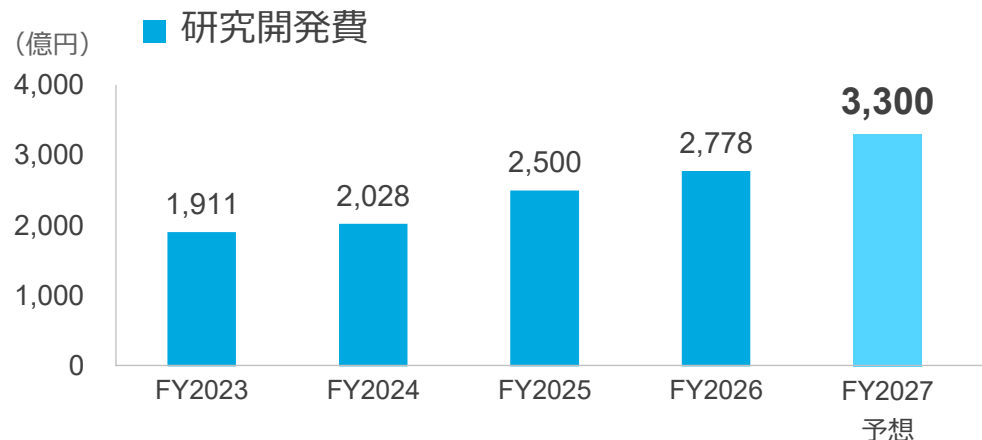


岩手県奥州市  
2025年11月 竣工

宮城生産革新センター  
エッチング装置

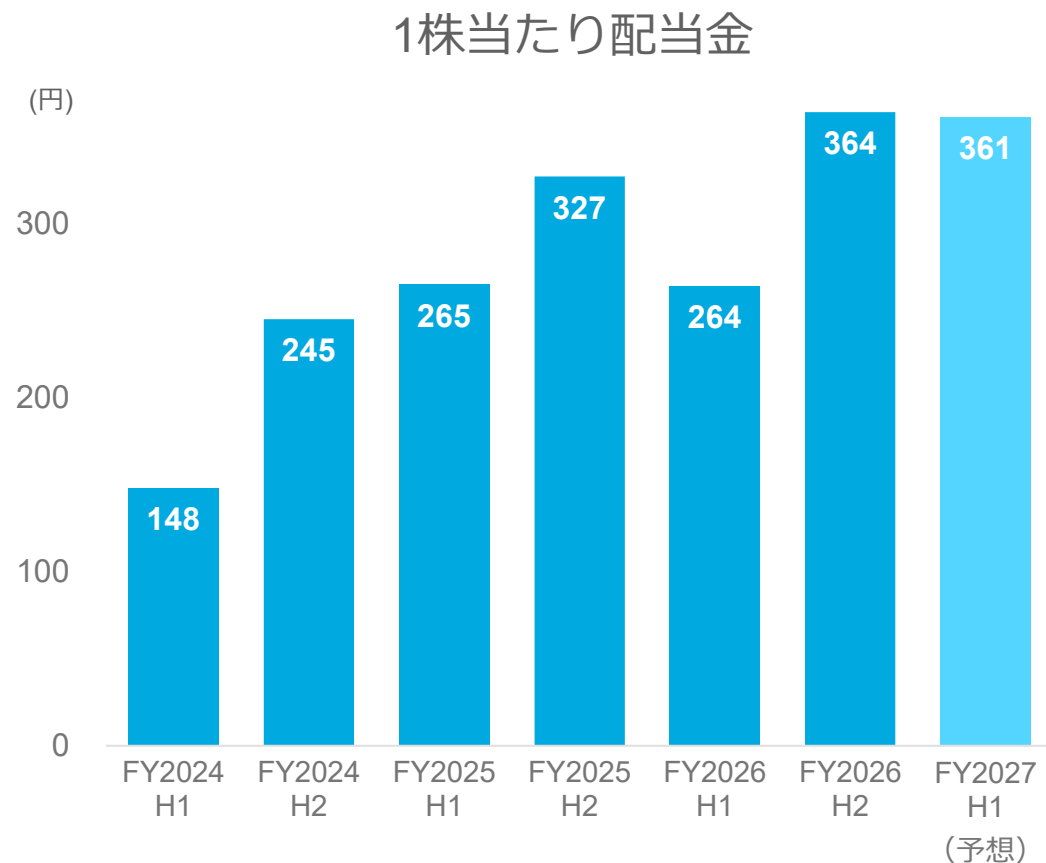


宮城県黒川郡  
2027年夏 竣工予定



研究開発投資を主軸に競争力の強化を継続  
強固なインフラを活用し、今後の収益機会を着実に捉える

# 配当予想



## 当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

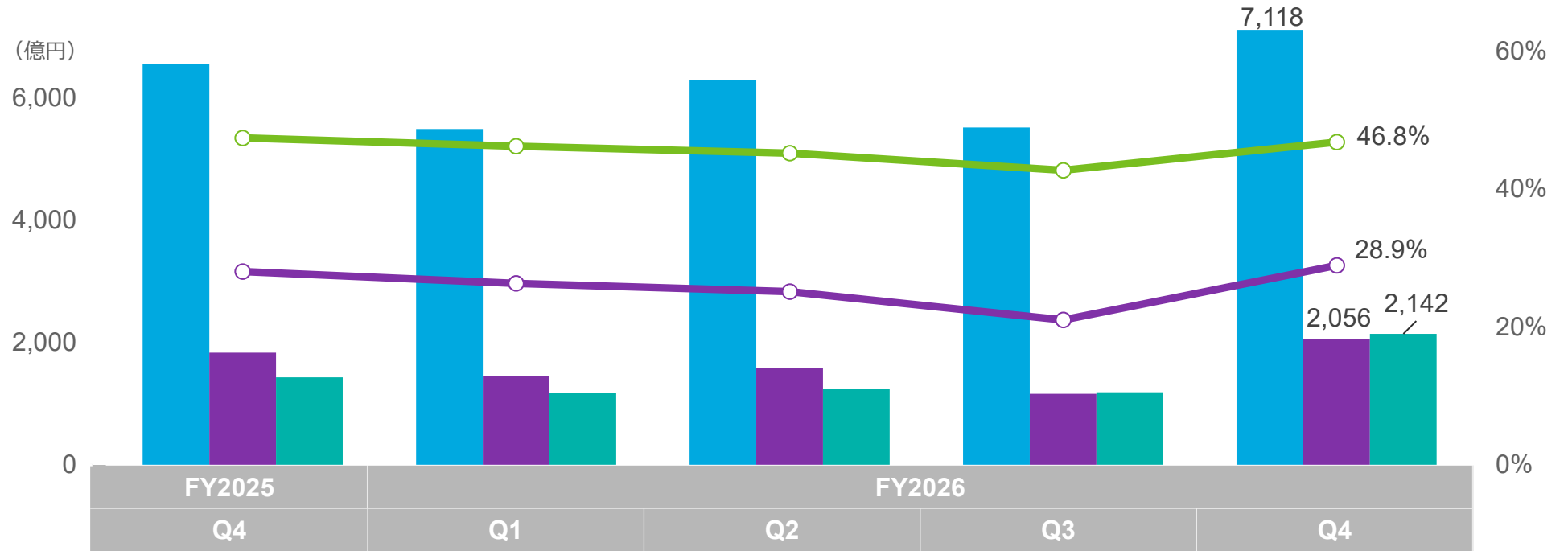
FY2027 H1（中間配当）の1株当たり配当金は361円を見込む

**TEL**

**TOKYO ELECTRON**

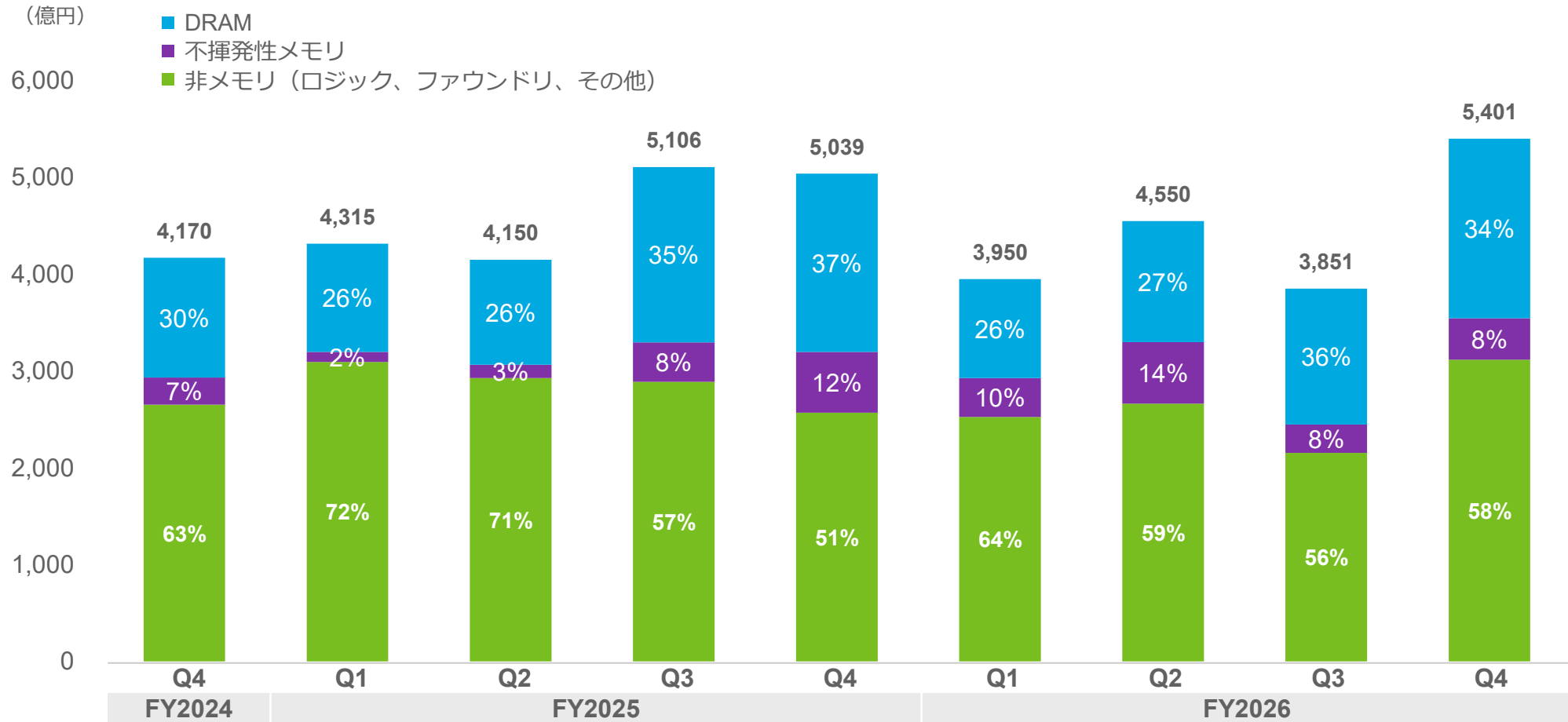
# 補足資料

# 損益状況 (四半期)



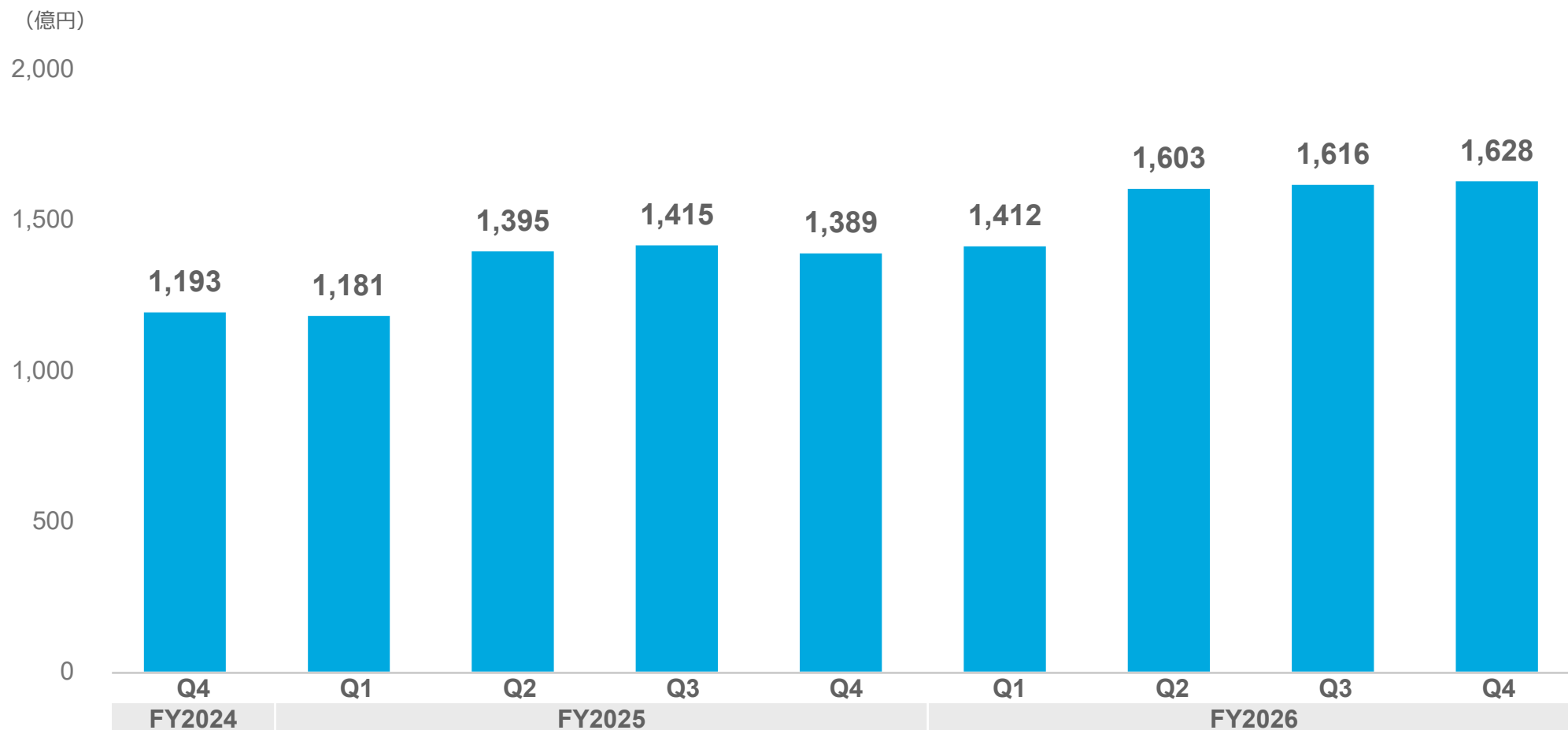
	FY2025		FY2026		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
■ 売上高	6,554	5,495	6,300	5,520	7,118
■ 営業利益	1,837	1,446	1,584	1,161	2,056
■ 親会社株主に帰属する当期純利益	1,429	1,178	1,238	1,185	2,142
○ 売上総利益率	47.4%	46.2%	45.2%	42.7%	46.8%
○ 営業利益率	28.0%	26.3%	25.1%	21.0%	28.9%

# SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比 (四半期)

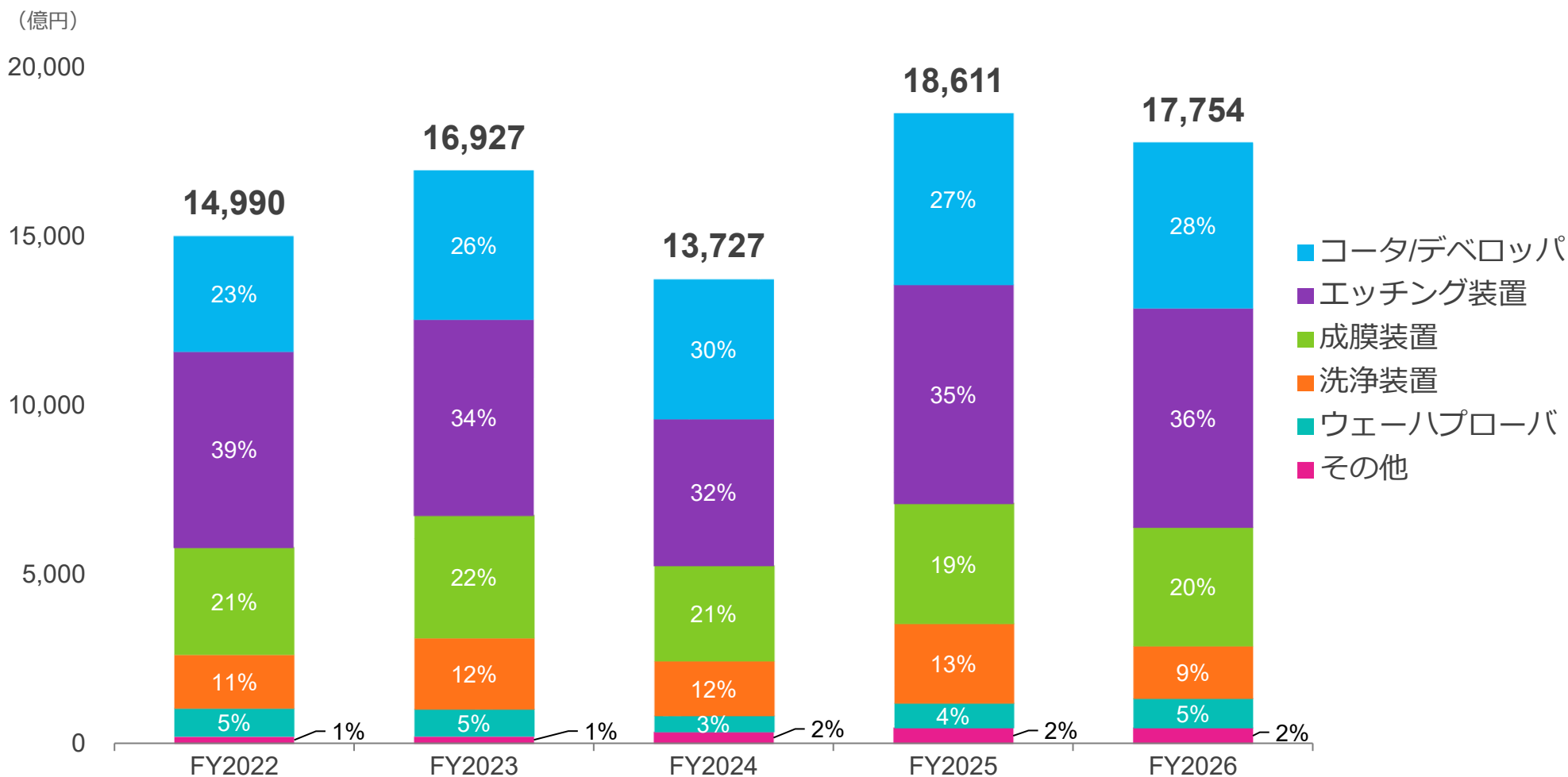


1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置  
 2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

# フィールドソリューション売上高（四半期）



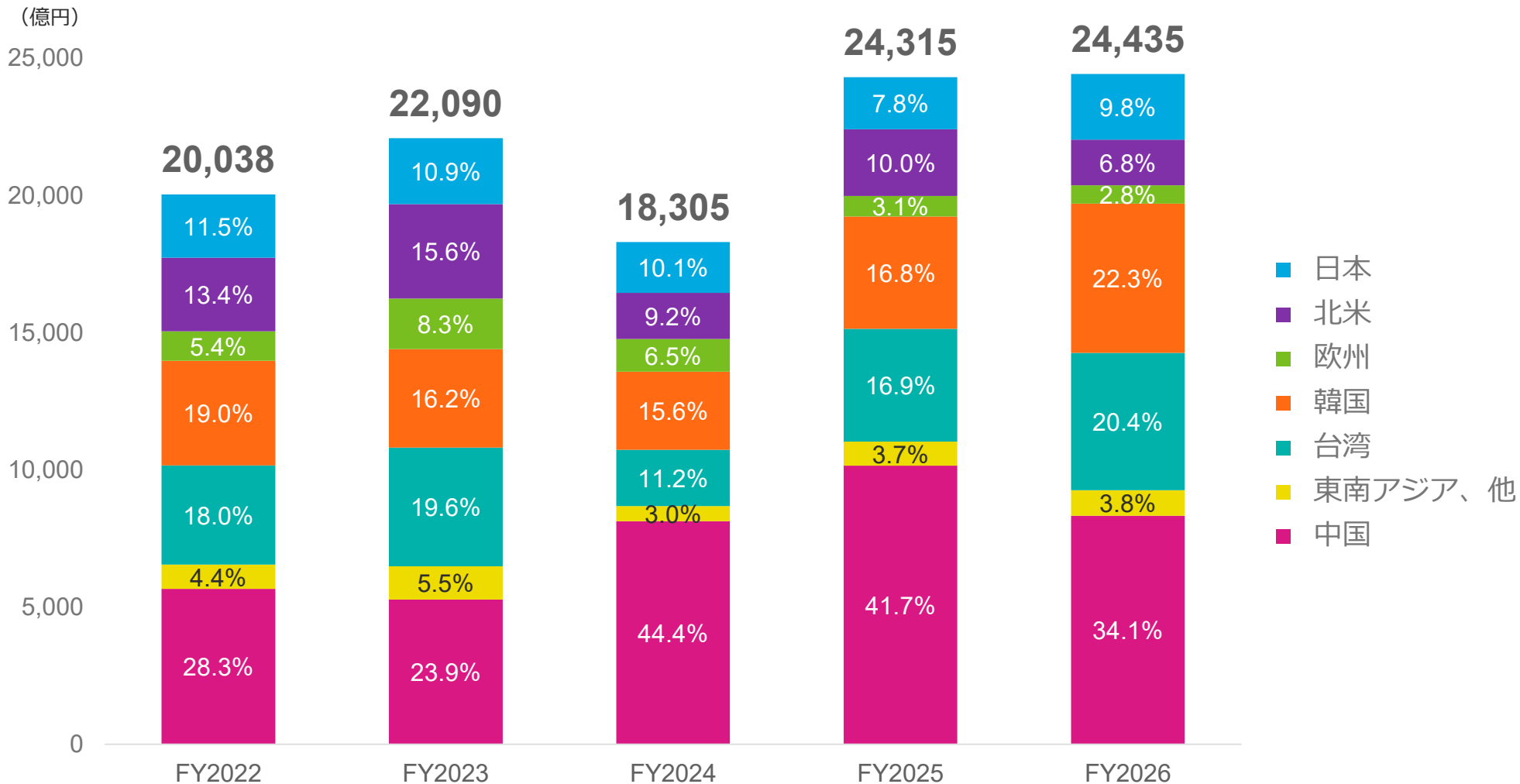
# SPE新規装置 製品別売上構成比



1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置

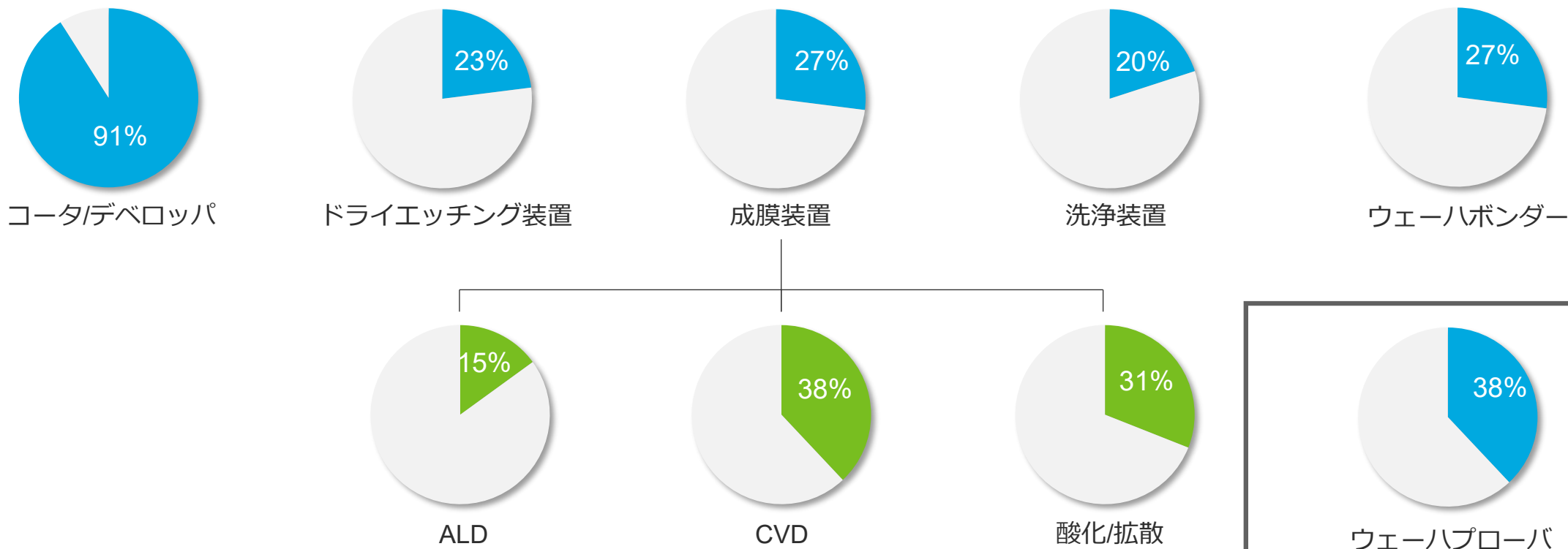
2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれておりません。

# 地域別売上高構成比



1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置  
 2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれておりません。

# 主要プロダクト 世界市場シェア (CY2025)



出所

Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2025, Bob Johnson and Menglin Cao, 2 April 2026, Revenue from Shipments basis.

チャートはガートナーリサーチに基づき、東京エレクトロンが作成。ここに記載のある数値は、東京エレクトロンにより算出されたものです。

コータ/デベロッパ: Photoresist Processing (Track), ドライエッチング装置: Dry Etch, 成膜装置: Tube CVD + Atomic Layer Deposition Tools + Oxidation/ Diffusion Furnaces + Nontube LPCVD, ALD: Atomic Layer Deposition Tools, CVD: Tube CVD + Nontube LPCVD, 酸化/拡散: Oxidation/Diffusion Furnaces, 洗浄装置: Single Wafer Processors + Wet Stations + Batch Spray Processors + Scrubbers + Other Clean Equipment ウェーハボンダー: Wafer Bonder GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ(以下「Gartnerコンテンツ」)は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.(以下「Gartner」)が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。

出所

半導体製造装置(ウェーハプローバ): Auto Probers,;

TechInsights Inc., April 2026

図はTechInsights Inc.に基づき、東京エレクトロンが作成。

# 本資料の取扱上の注意

当社の書面による承諾なしに複写、または第三者への開示はできません。

東京エレクトロン

**TEL** および“TEL”は、東京エレクトロン株式会社の商標です。